

特 許 協 力 条 約

PCT

REC'D 05 AUG 2004

WIPO PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

(法第12条、法施行規則第56条)
(PCT 36条及びPCT規則70)

出願人又は代理人 の書類記号 F-1004	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP03/10057	国際出願日 (日.月.年) 07.08.2003	優先日 (日.月.年) 09.08.2002
国際特許分類 (IPC)	Int. Cl ⁷ H01L21/66	
出願人 (氏名又は名称) JSR株式会社		

1. この報告書は、PCT 35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。
法施行規則第57条 (PCT 36条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。

a ☒ 附属書類は全部で 3 ページである。

☒ 補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙 (PCT 規則70.16及び実施細則第607号参照)

☐ 第I欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙

b ☐ 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第802号参照)

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

☒ 第I欄 国際予備審査報告の基礎

☐ 第II欄 優先権

☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成

☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如

☒ 第V欄 PCT 35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明

☐ 第VI欄 ある種の引用文献

☐ 第VII欄 国際出願の不備

☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 04.03.2004	国際予備審査報告を作成した日 15.07.2004		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員)	4R	9265
	坂本 薫昭 電話番号 03-3581-1101 内線 6363		

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (2004年1月)

第 I 欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、_____ 語による翻訳文を基礎とした。

それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査

☐ PCT規則12.4にいう国際公開

☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書

第 1-80 _____ ページ、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☒ 請求の範囲

第 3-8 _____ 項、出願時に提出されたもの

第 _____ 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの

第 2 _____ 項*、08.07.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ 項*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☒ 図面

第 1/12-12/12 _____ ページ/図、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ/図*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ/図*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☒ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ

☒ 請求の範囲 第 1 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること)

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 _____ ページ

☐ 請求の範囲 第 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること)

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)

* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)	請求の範囲 2-8	有 無
	請求の範囲	
進歩性(IS)	請求の範囲 2-8	有 無
	請求の範囲	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 2-8	有 無
	請求の範囲	

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: WO 02/47149 A1 (ジェイエスアール株式会社)
2: JP 2002-203879 A (ジェイエスアール株式会社)

請求の範囲2-8に記載された発明は、国際調査報告に引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。文献1-2には、検査用回路基板の表面に配置されて検査用回路基板とウエハとを電氣的に接続するための異方導電性コネクタにおいて、弾性異方導電膜は、その接続用導電部の合計の数を Y とし、弾性異方導電膜に対してその厚み方向に $Y \times 1\text{ g}$ の荷重を加えた状態における接続用導電部の電気抵抗を R_{1g} とし、弾性異方導電膜に対してその厚み方向に $Y \times 6\text{ g}$ の荷重を加えた状態における接続用導電部の電気抵抗を R_{6g} としたとき、 R_{1g} の値が $1\text{ }\Omega$ 未満である接続用導電部の数が全接続用導電部の数の90%以上であり、 R_{6g} の値が $0.1\text{ }\Omega$ 未満である接続用導電部の数が全接続用導電部の数の95%以上であり、 R_{6g} の値が $0.5\text{ }\Omega$ 以上である接続用導電部の数が全接続用導電部の数の1%以下である初期特性を有する異方導電性コネクタが記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。

請 求 の 範 囲

1. (削除)

2. (補正後) ウエハに形成された複数の集積回路の各々について、当該集積回路の電氣的検査をウエハの状態で行うために、検査用回路基板の表面に配置されて当該検査用回路基板とウエハとを電氣的に接続するための異方導電性コネクタにおいて、

検査対象であるウエハに形成された全てのまたは一部の集積回路における被検査電極が配置された電極領域に対応してそれぞれ厚み方向に伸びる複数の異方導電膜配置用孔が形成されたフレーム板と、このフレーム板の各異方導電膜配置用孔内に配置され、当該異方導電膜配置用孔の周辺部に支持された複数の弾性異方導電膜とよりなり、

前記弾性異方導電膜の各々は、検査対象であるウエハに形成された集積回路における被検査電極に対応して配置された、磁性を示す導電性粒子が密に含有されてなる厚み方向に伸びる複数の接続用導電部、およびこれらの接続用導電部を相互に絶縁する絶縁部を有する機能部と、この機能部の周縁に一体に形成され、前記フレーム板における異方導電膜配置用孔の周辺部に固定された被支持部とよりなり、

前記弾性異方導電膜は、その接続用導電部の合計の数を Y とし、当該弾性異方導電膜に対してその厚み方向に $Y \times 1 \text{ g}$ の荷重を加えた状態における接続用導電部の電気抵抗を R_{1g} とし、当該弾性異方導電膜に対してその厚み方向に $Y \times 6 \text{ g}$

の荷重を加えた状態における接続用導電部の電気抵抗を R_{eg} としたとき、 R_{ig} の値が 1Ω 未満である接続用導電部の数が全接続用導電部の数の 90% 以上であり、 R_{eg} の値が 0.1Ω 未満である接続用導電部の数が全接続用導電部の数の 95% 以上であり、 R_{eg} の値が 0.5Ω 以上である接続用導電部の数が全接続用導電部の数の 1% 以下である初期特性を有することを特徴とする異方導電性コネクタ。

3. フレーム板の線熱膨張係数が $3 \times 10^{-5}/K$ 以下であることを特徴とする請求の範囲第2項に記載の異方導電性コネクタ。

4. ウエハに形成された複数の集積回路の各々について、当該集積回路の電氣的検査をウエハの状態で行うために用いられるプローブ部材であって、

検査対象であるウエハに形成された集積回路における被検査電極のパターンに対応するパターンに従って検査電極が表面に形成された検査用回路基板と、この検査用回路基板の表面に配置された、請求の範囲第2項または第3項に記載の異方導電性コネクタとを具備してなることを特徴とするプローブ部材。

5. 異方導電性コネクタにおけるフレーム板の線熱膨張係数が $3 \times 10^{-5}/K$ 以下であり、検査用回路基板を構成する基板材料の線熱膨張係数が $3 \times 10^{-5}/K$ 以下であることを特徴とする請求の範囲第4項に記載のプローブ部材。

6. 異方導電性コネクタ上に、絶縁性シートと、この絶縁性シートをその厚み方向に貫通して伸び、被検査電極のパターンに対応するパターンに従って配置された複数の電極構造体とよりなるシート状コネクタが配置されていることを特徴とする請求の範囲第4項または第5項に記載のプローブ部材。

7. ウエハに形成された複数の集積回路の各々について、当該集積回路の電氣的検査をウエハの状態で行うウエハ検査装置において、

請求の範囲第4項乃至第6項のいずれかに記載のプローブ部材を具備してなり、当該プローブ部材を介して、検査対象であるウエハに形成された集積回路に対する電氣的接続が達成されることを特徴とするウエハ検査装置。

8. ウエハに形成された複数の集積回路の各々を、請求の範囲第4項乃至第6項のいずれかに記載のプローブ部材を介してテスターに電氣的に接続し、当該ウエ

ハに形成された集積回路の電氣的検査を実行することを特徴とするウエハ検査方法。